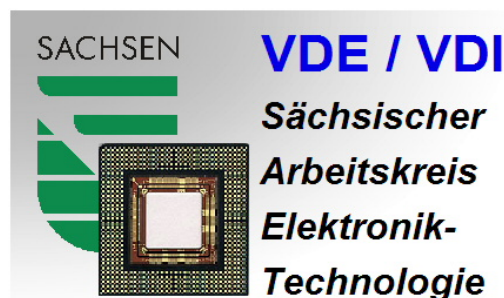


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer  
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden  
e-mail: reinhard.bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: PD, Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden  
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de

<https://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/arbeitskreis/>



## **77. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie**

**FED**

Fachverband für Design,  
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

Thema: **Gemeinsames Online-Treffen mit dem FED e.V.  
„Technologischer Fortschritt auch in Corona-Zeiten“**

am **Mittwoch, 08. Dezember 2021**

Ort **GoToWebinar**

### **Programm:**

- 10:00 Uhr Begrüßung durch Reinhard Bauer (Obmann SAET) und Martin Wedel (FED)
- 10:20 Uhr **Geschichte und Anliegen des VDE/VDI Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie**  
*Prof. Reinhard Bauer, HTW Dresden*
- 10:40 Uhr **Vorstellung des FED e.V. und aktuelle Arbeiten in der Regionalgruppe Hamburg + Hamburger Lötzirkel**  
*Martin Wedel, KOKI Deutschland und FED e.V.*
- 11:00 Uhr **Herausforderung Fehlerproduktion! Entwicklung und Fertigung eines Fehlerboards zur Evaluierung von Röntgenanlagen für die Elektronikfertigung**  
*Dipl.-Ing. Victoria Constance Köst, TU Dresden, IAVT*
- 11:25 Uhr **Erweiterte Möglichkeiten der dynamischen Topografiemessung**  
*MSc. Oliver Albrecht, TU Dresden, ZmP*
- 11:50 Uhr **Trends in der AVT – Von 3D gedruckten Kupferstrukturen bis Stretchable und Conformable**  
*Dr. Jan Kostelnik, TEBKO*
- 12:15 Uhr **Disruptiver Ansatz additiv hergestellter Schaltungsträger**  
*Michael Schleicher, SEMIKRON Elektronik GmbH & Co.KG & FED e.V.*

12:40 Uhr **Kann das funktionieren? Analyse der Löt- oder Sinterverbindung zwischen DCB und Die mittels Kontaktthermografie**  
*Dr. Martin Oppermann, TU Dresden, ZmP*

13:05 Uhr **Abschlussdiskussion**  
*Martin Wedel & Reinhard Bauer*